

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Juli 2005 (14.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/063909 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C09J 7/00,  
G06K 19/077

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053632

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
21. Dezember 2004 (21.12.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 61 541.5 23. Dezember 2003 (23.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): TESA AG [DE/DE]; Kst. 9500 - Bf. 645, Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUSEMANN, Marc [DE/DE]; Strehlowweg 48, 22605 Hamburg (DE). BARGMANN, Renke [DE/DE]; Hagenbeckstrasse 35, 22527 Hamburg (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: TESA AG; Kst. 9500 - Bf. 645, Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ADHESIVE FILM USED TO IMPLANT ELECTRIC MODULES IN A CARD BODY

(54) Bezeichnung: KLEBFOLIE ZUR IMPLANTIERUNG VON ELEKTRISCHEN MODULEN IN EINEN KARTENKÖRPER

(57) Abstract: The invention relates to an adhesive film, comprising a blend made of synthetic rubber S1 and thermoplastics 2 which are used to stick electric modules to chip cards. According to the invention, a) the blend is separated into microphases; b) the blend has at least two softening temperatures, wherein at least one softening temperature is higher than 65 °C and lower than 125 °C; c) a G' measured according to test method A at 23 °C is 10<sup>7</sup> Pas; d) a G" measured according to test method A at 23 °C is 10<sup>6</sup> Pas; e) and a crossover measured according to test method A is less than 125 °C.

(57) Zusammenfassung: Klebstofffolie, bestehend aus einem Blend aus einem synthetischen Kautschuk S1 und einem Thermoplasten 2, wobei a) der Blend mikrophasengetrennt ist; b) der Blend mindestens 2 Erweichungstemperaturen besitzt, wobei mindestens eine Erweichungstemperatur grösser 65°C und kleiner 125°C ist; c) einen nach Testmethode A gemessenen G' bei 23°C von grösser 10<sup>7</sup> Pas besitzt; d) einen nach Testmethode A gemessenen G" bei 23°C von grösser 10<sup>6</sup> Pas besitzt; e) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125°C aufweist zur Verklebung von elektrischen Modulen in Chipkarten.

**WO 2005/063909 A1**